

【起因・判断ポイント・発生工程】銀スルーホール用オーバコート印刷工程の合わせズレや、オーバコート印刷版の歪などにより、銀ペースト部にオーバコートが重ならずに出てきたもの（銀スルーホール用オーバコート印刷工程）

【原因、判断要点、発生工序】在印刷工序，因为银通孔的表面涂层的对位不准、或者网版的偏移等，致使表面涂层不能覆盖银膏而引起的（表面涂层印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
Overcoat does not accurately cover the silver pasted area due to misalignment in the overcoat printing process on silver through holes or a distorted overcoat printing screen. (Printing process for overcoat for silver through hole)



【コメント】
顕微鏡倍率×60

【注釋】
显微镜倍率 ×60

【Comments】
Magnification: ×60

5-2-4 銀ペースト飛び／銀膏的飞溅／ Splash of silver paste

【特徴】銀ペーストが飛散して、ソルダレジスト表面や、導体表面に付着している状態の欠陥

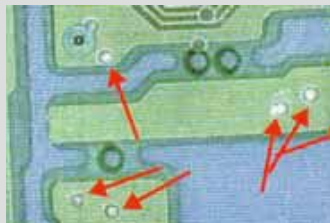
【特征】銀膏飞溅，溅落到 SR 表面或者导线表面的缺陷。

【Characteristics】Silver paste is splashed and adhered to the surfaces of solder resist or conductor.

【起因・判断ポイント・発生工程】銀ペースト印刷作業の不注意などにより、銀ペーストを飛ばして余分な所に付着させて出来たもの（銀スルーホール印刷工程）

【原因、判断要点、発生工序】因为疏忽等，印刷作业时银膏飞溅，溅落在指定部位以外所引起的（银通孔印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
Silver paste is splashed and adhered to unwanted areas by careless operation in silver paste printing, causing the defects. (Silver through hole printing process)



【コメント】
顕微鏡倍率×20

【注釋】
显微镜倍率 ×20

【Comments】
Magnification: ×20



【コメント】
顕微鏡倍率×60

【注釋】
显微镜倍率 ×60

【Comments】
Magnification: ×60

5-2-5 銀充填過多／銀膏的充填过量／ Excessive silver paste filling

【特徴】銀ペーストが多すぎてはみ出したり、隣接ランドと短絡している状態の欠陥

【特征】銀膏太多，挤出后与相邻的焊环连接成为短路的缺陷。